

Unitech Printed Circuit Board Corp.

耀華電子股份有限公司

中華民國台灣新北市土城區中山路四巷3號

Tel : +886-2-22685071
FAX : +886-2-22687824
www.pcbut.com.tw

2026/06/26

吳錦芳

副總經理 / 發言人

TEL : +886-2-2268-5071

Email : kanty-wu@pcbuc.com.tw

Unitech

耀華電子股份有限公司

Unitech Printed Circuit Board Corp.

劉長寧

高級專員 / 代理發言人

TEL : +886-2-2268-5071

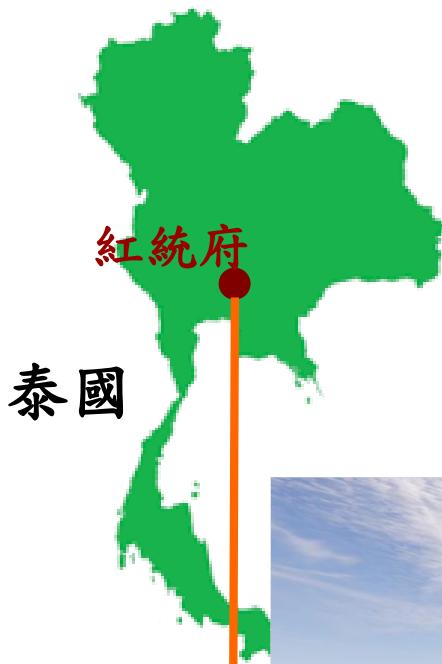
Email : Charlie-liou@pcbuc.com.tw

免責聲明

- 我們對報告內容或基於本報告的任何行為概不負責，也不作任何明示或暗示的保證或承諾。 Unitech或其任何一名員工均不對本報告文稿中包含或不包含的信息的完整性或準確性承擔責任。該報告文稿不包括或不構成任何提議的一部分，也不構成或構成任何種類計畫說明書的一部分。
- 本報告文稿包含一些未來性陳述。實際結果可能與這些未來性陳述中預測或暗示的情況大不相同。未來性信息涉及可能對預期結果產生顯著影響的風險和不確定性。
- 本報告的內容屬於機密性質，且所有內容由耀華保留其所有權。

Factory Location

Unitech



台北

宜蘭



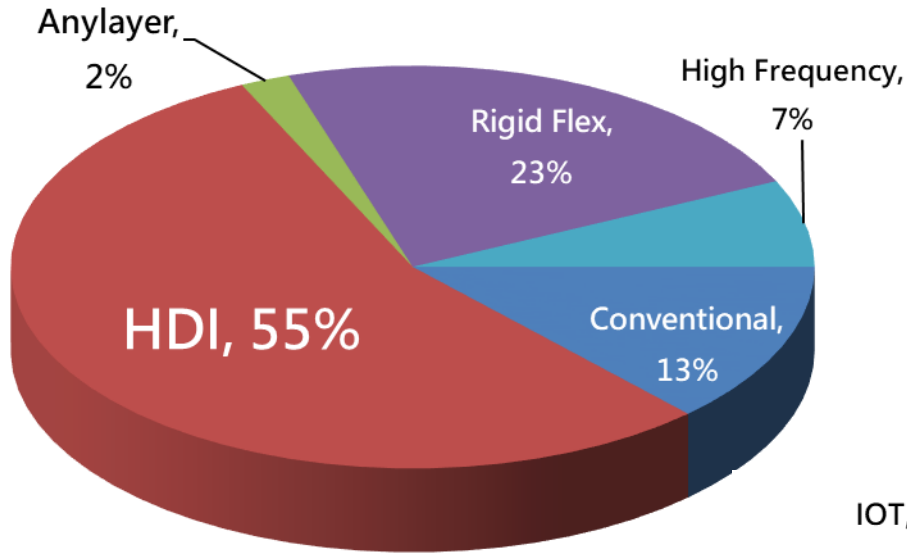
Unitech

公司基本資料

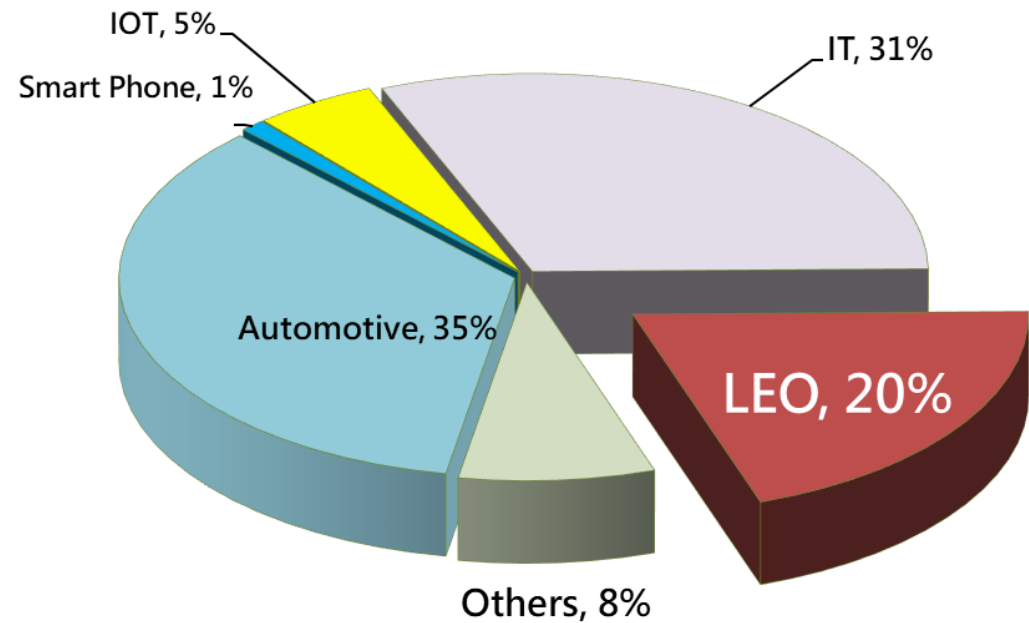
	台灣	上海展華(南通)	耀華(泰國)
資本額(2026/1Q)	7,062,532	4,716,944	2,690,050
總資產(2026/1Q)	25,807,672	8,629,783	3,630,007
成立時間	1984	2018	2024
產能(SF/月)	1300K	800K	200K
員工數	4600	1400	470

1. 資本額及總資產計算單位為新台幣仟元。
2. 人民幣兌新台幣匯率以4.6290計。
3. 泰銖兌新台幣匯率以0.9782計。

產品銷售分類-以技術別區分 (2026 1H 預估)



產品銷售分類-以應用別區分 (2026 1H 預估)



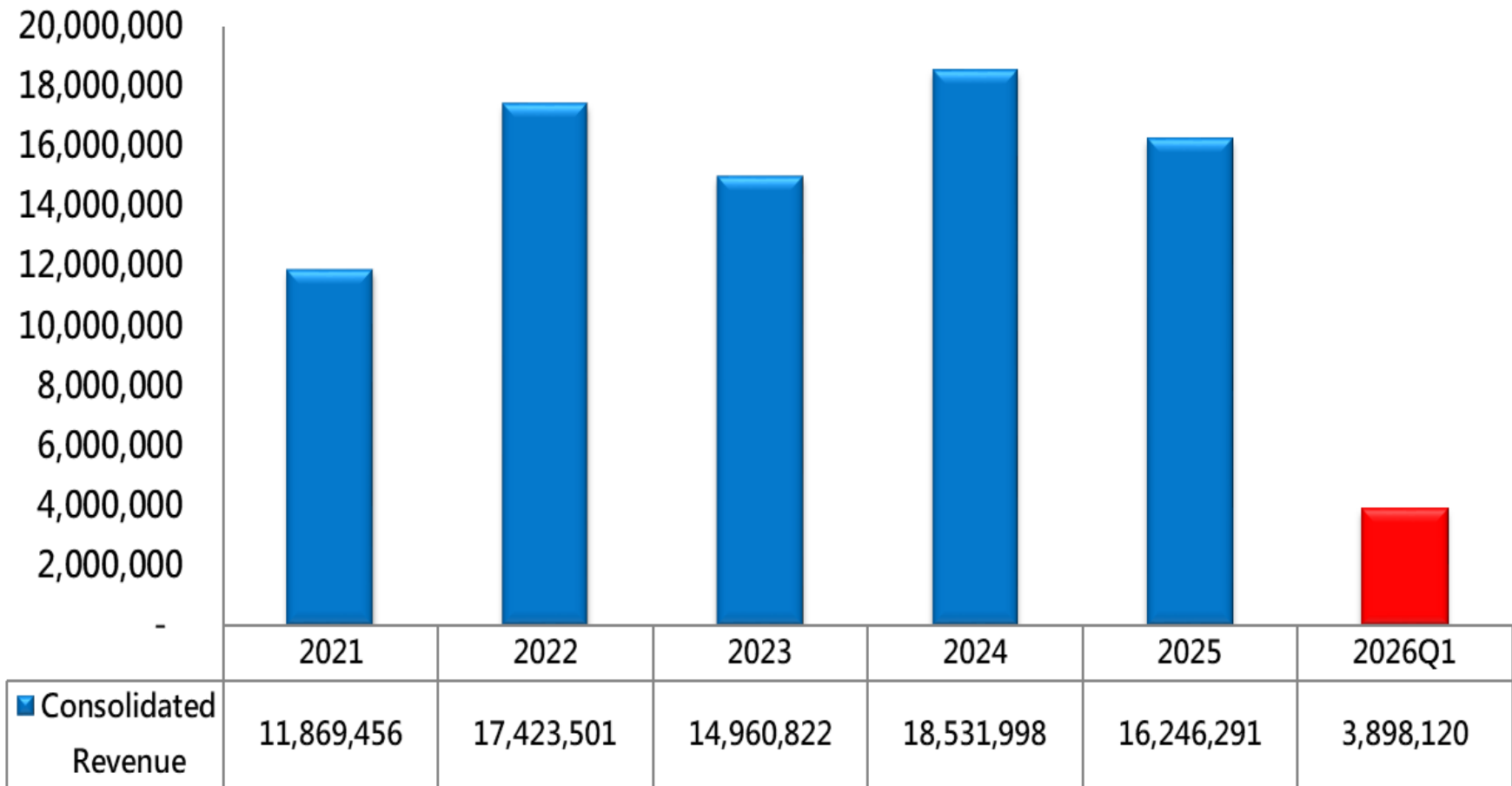
項目	產品及形態		2025A	2024A
應用端	汽車		35%	37%
	智慧手持	手機	1%	2%
		IOT	5%	6%
		IT	35%	28%
	LEO		15%	19%
	其他		9%	8%
技術面	軟硬板		31%	32%
	Anylayer		2%	2%
	HDI		45%	49%
	傳統板		15%	10%
	高頻板		7%	7%

項目	產品及形態		2026 1Q	2025 1Q
應用端	汽車		36%	35%
	智慧手持	手機	1%	1%
		IOT	5%	5%
		IT	31%	35%
	LEO		19%	16%
	其他		8%	8%
技術面	軟硬板		22%	31%
	Anylayer		2%	2%
	HDI		56%	45%
	傳統板		13%	15%
	高頻板		7%	7%

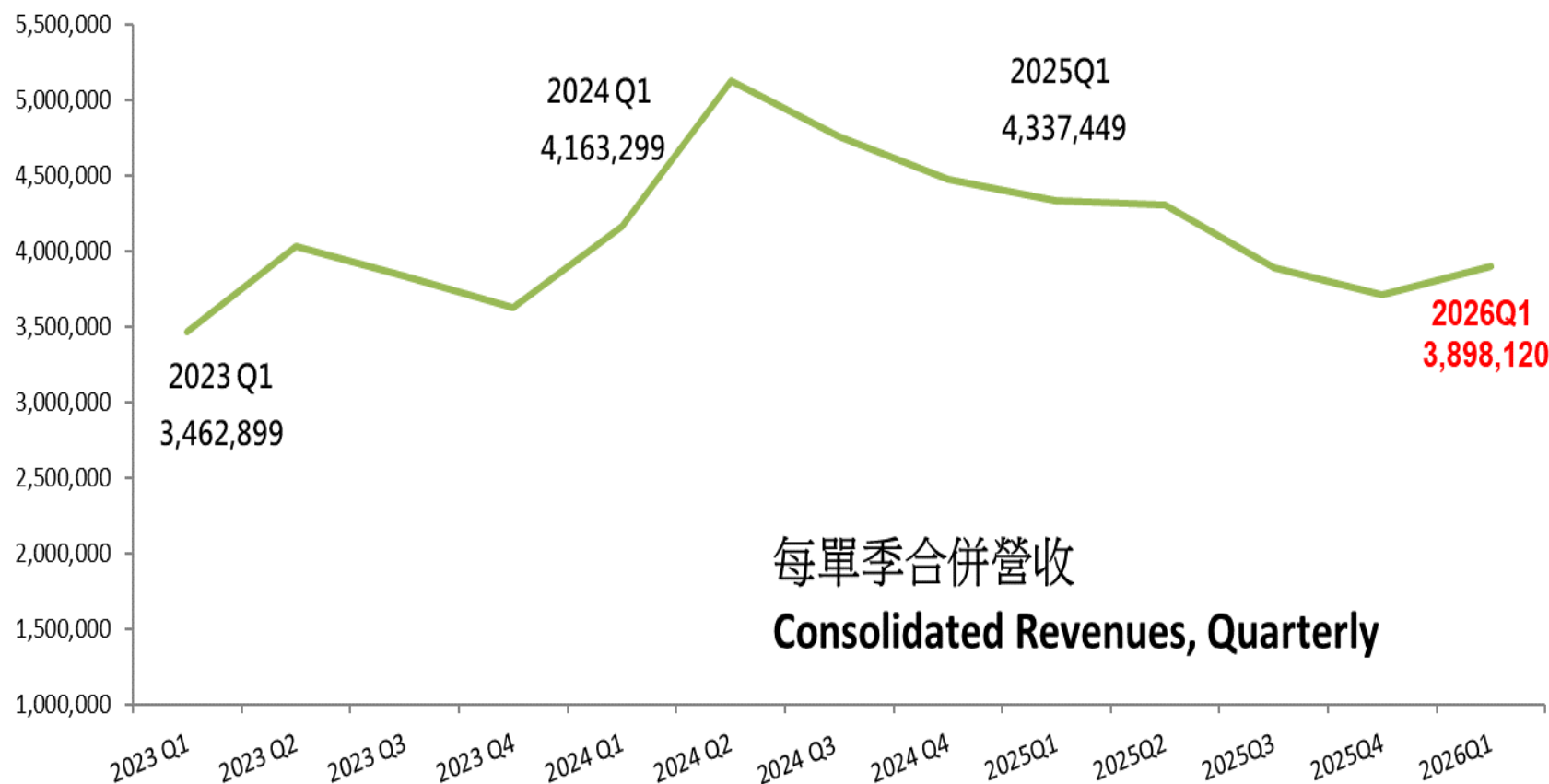
項目	產品及形態		2026 1H(F)	2025 1H(A)
應用端	汽車		35%	35%
	智慧手持	手機	1%	1%
		IOT	5%	5%
		IT	31%	35%
	LEO		20%	17%
	其他		8%	7%
技術面	軟硬板		23%	31%
	Anylayer		2%	2%
	HDI		55%	45%
	傳統板		13%	15%
	高頻板		7%	7%

近5年度合併營收

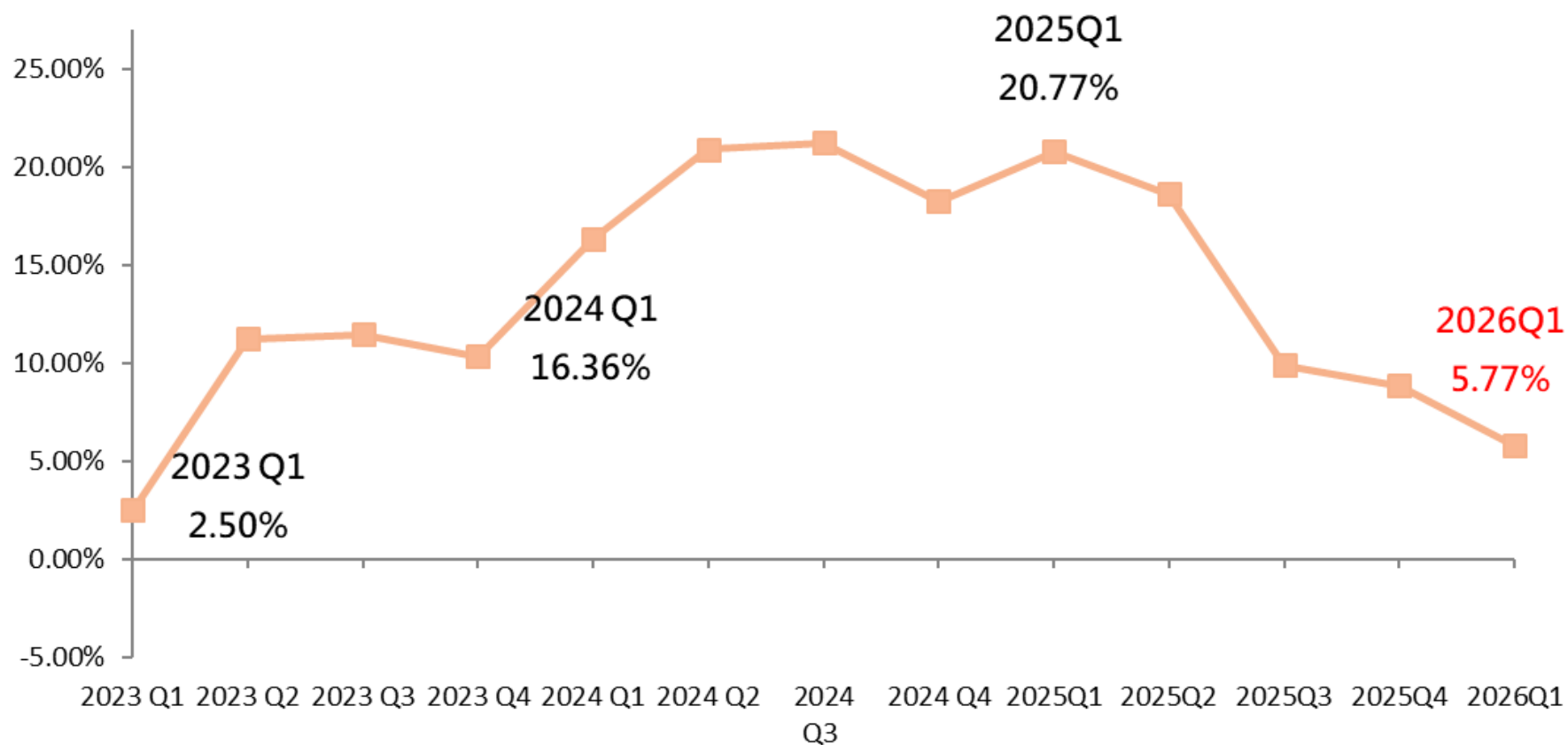
Consolidated Revenues, annually



單位：新台幣仟元



單位：新台幣仟元

每單季毛利率 **Gross Margin Rate, Quarterly**

1. 全球PCB產業已逐步走出庫存調整週期，市場成長動能由傳統消費性電子逐漸轉向AI基礎建設、高速網通及衛星通訊等高附加價值應用，高階PCB需求成長速度持續優於整體市場。
2. AI伺服器、高速交換器及光通訊模組需求快速增加，推動高層數板、高速傳輸及高可靠度產品需求成長。隨AI運算規模持續擴大，高階PCB市場可望維持長期成長趨勢。
3. 低軌衛星（LEO）產業持續發展，衛星數量增加及地面通訊設備升級帶動高頻高速傳輸需求，相關PCB應用逐步由開發階段進入量產階段。
4. 全球供應鏈區域化趨勢持續深化，國際客戶加速推動China+1策略，非中國產能需求增加，東南亞逐步成為全球電子製造重要生產基地。
5. 汽車及消費性電子市場仍受終端需求及產業庫存調整影響，短期成長動能相對溫和，惟中長期電子化及智慧化趨勢仍有助支撐市場需求。

供給 VS. 需求

1. AI基礎建設投資持續增加，高速運算及光通訊需求快速成長，高階PCB需求增幅明顯高於整體產業平均，市場供需維持相對健康狀態。
2. 高層數板、高階HDI及高速材料產品技術門檻持續提高，高良率量產能力已成為客戶選擇供應商的重要考量因素，市場競爭逐步由價格導向轉向技術導向。
3. 市場需求逐步集中於AI、高速網通、衛星通訊及車用電子等高技術門檻應用，高附加價值產品成長速度明顯優於標準型產品。
4. 全球客戶持續提高非中國供應鏈採購比例，東南亞高階PCB產能需求快速增加，供應鏈區域化趨勢已成為產業長期發展方向。
5. 產業競爭模式由追求產能規模逐步轉向產品技術、品質能力及供應鏈韌性，高階與一般PCB產品之間的獲利差距持續擴大。

營收及獲利的成長動能

1. LEO Satellite：已進入穩定量產階段，目前約占整體營收15%~20%，主要應用於地面接收設備。隨衛星通訊需求持續成長，亦逐步切入衛星本體相關應用，目前已進入樣品開發階段。
2. Thailand Factory：泰國廠已於第二季正式量產，目前以LEO相關產品為主要生產項目。未來除支援國際客戶區域化供應鏈需求外，亦可作為公司拓展全球市場的重要生產基地。
3. AI Infrastructure：持續布局AI伺服器相關應用，目前聚焦Optical Module、高速傳輸及AI Server配板開發，並透過HLC及HDI產品切入AI基礎建設供應鏈。
4. HLC & HDI Upgrade：隨AI應用由Training AI逐步延伸至Inference AI及Physical AI，帶動智慧終端、機器人及自動化設備等新興應用發展，推升高密度互連及高可靠度PCB需求。持續深化HLC及HDI產品布局，掌握下一波AI應用成長機會。
5. Automotive & Consumer Applications：持續深耕車用及消費性產品市場，雖短期受終端需求及產業調整影響，市場復甦速度仍需觀察，但相關產品仍為穩定營運的重要基礎。

綠色耀華、環境永續

- 耀華以「積極創新、團結和諧、客戶導向、謹守誠信」為經營理念，奠定「永續企業」的發展根基，面對未來充滿挑戰的經營環境，在經濟、環境及社會議題上，規劃適切短、中及長期發展計畫，履行邁向永續發展的承諾及願景。
- 跟隨著ESG國際永續經營趨勢，耀華電子也規劃了一系列節能減碳策略，包括購買及自建再生能源，並訂定廠區減碳目標，積極接軌低碳製造趨勢，結合ICT科技推動智慧製造，往低碳企業的目標邁進。
- 耀華電子將持續秉持誠信經營態度及永續思維，接軌國際永續標準及系統，不斷精進自身永續能力，透過全員落實永續作為，並持續透過研發，提供以客為主、具創新的技術及製造服務，持續引領PCB產業向上提升，邁向永續發展願景。

Thank You !!!